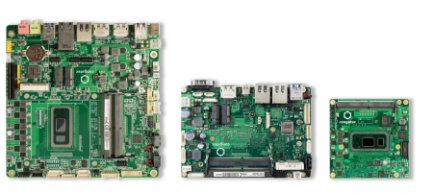
****

|  |  |
| --- | --- |
| **Domande dei lettori:** | **Contatto Stampa:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network** |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Phone: +49-991-2700-0 | Phone: +49-2405-4526720 |
| [info@congatec.com](mailto:info@congatec.com)  [www.congatec.it](http://www.congatec.it) | [info@sams-network.com](mailto:info@prismapr.com)  [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com) |



*Testo e foto disponibili presso:* [*https://www.congatec.com/it/congatec/comunicato-stampa.html*](https://www.congatec.com/it/congatec/comunicato-stampa.html)

**Comunicato stampa**

Equipaggiate con i processori Intel® Core™ Mobile di 8a generazione, le nuove schede congatec sono disponibili per un periodo superiore a 10 anni

**Incremento delle prestazioni fino al 58%   
e disponibilità estesa fino a 15 anni**

**Deggendorf, Germania, 11 Giugno 2019 \* \* \*** congatec – azienda leader nella realizzazione di moduli e schede di elaborazione embedded sia standard sia custom – ha annunciato che le nuovissime versioni embedded dei processori Intel® Core™ Mobile di 8a generazione (nome in codice Whiskey Lake) sono ora disponibili sui moduli COM Express Compact con pinout Type 6, sui Single Board Computer (SBC) da 3,5” e sulle schede madri in formato Thin Mini-ITX della società. I clienti OEM possono beneficiare immediatamente di un incremento delle prestazioni fino al 58% rispetto a quelle ottenibili con i processori della precedente Serie U grazie all'utilizzo di 4 core (invece di 2) e ai miglioramenti apportati a livello di microarchitettura. Caratteristiche quali la presenza di una memoria Intel® Optane™ (opzionale) M.2 o di interfacce USB 3.1 Gen 2 garantiscono una maggiore velocità e affidabilità di risposta dei processi che vengono comunemente eseguiti. I core del processore consentono anche un'efficiente schedulazione dei task e supportano l'uso del software hypervisor RTS per assicurare un'ulteriore ottimizzazione del throughput di I/O dai canali di ingresso ai core del processore.

Progettati per l'uso in applicazioni che prevedono ambienti gravosi e con vincoli severi in termini di spazio, i nuovi moduli e schede di fascia alta equipaggiati con processori embedded Intel® Core™ i7, Core™ i5, Core™ i3 e Celeron® sono i primi in assoluto a garantire una disponibilità per un periodo superiore a 10 anni. Tra tutti i produttori di schede embedded congatec è stata la prima azienda a rendere disponibili schede equipaggiate con i processori Intel® Core™ Mobile di 8a generazione[[1]](#endnote-2). Destinati in particolare a soddisfare l’esigenza di un’estensione dei cicli di vita, molto sentita nel settore dei trasporti e della mobilità, i nuovi moduli e schede di congatec rappresentano la soluzione ideale per un gran numero di altre applicazioni embedded – dalle apparecchiature medicali ai controlli industriali, dai client embedded utilizzati alla periferia della rete (edge) alle interfacce operatore (HMI) – in quanto garantiscono cicli di vita più lunghi senza alcun aggravio di costi per i clienti.

“Uno dei nostri principali obiettivi è semplificare il più possibile l'uso della tecnologia di elaborazione embedded per i nostri clienti” - ha detto Christian Eder, direttore marketing di congatec. “Questo è il motivo per il quale garantiamo già da ora la disponibilità dei nostri moduli e schede madri equipaggiati con i processori Intel® Core™ Mobile di 8a generazione per un periodo superiore a 10 anni. Periodo che può essere esteso per ulteriori 5 anni in base a specifici contratti LTB (Last Time Buy). “Ci siamo resi conto – ha proseguito Eder – che 7 anni sono spesso insufficienti per molte applicazioni di elaborazione embedded di fascia alta e l’estensione del ciclo di vita, che non comporta peraltro costi aggiuntivi, permette agli OEM di prolungare la durata dei loro prodotti e ottenere un ritorno sugli investimenti ancora migliore”.

In passato i cicli di vita di numerose applicazioni embedded di fascia alta erano inferiori a 7 anni in quanto spesso era necessario l’utilizzo di processori di nuova generazione per incrementare sensibilmente le prestazioni prima dello scadere di questo periodo. Complice l’aumento delle richieste di certificazione in parecchie nuove applicazioni embedded, come ad esempio i veicoli mobili, gli OEM richiedono ora la disponibilità di prodotti con cicli di vita più lunghi. L’estensione della durata delle piattaforme standard in architettura x86 embedded a 10 (o addirittura 15) anni è sicuramente un grosso vantaggio per il mercato dell’elaborazione embedded nel suo complesso.

“Siamo molto soddisfatti di poter iniziare a utilizzare la versione embedded di questa nuova architettura Intel con disponibilità garantita per oltre 10 anni” – ha commentato Thomas Hagios, CEO di MCTX Mobile & Embedded Computers GmbH. “Cicli di vita più lunghi rappresentano un requisito fondamentale in molte applicazioni mobili che operano in ambienti gravosi, dove è necessario acquisire e registrare in modo cronologico flussi di dati a elevata velocità per il riconoscimento di oggetti in 3D, generazione di immagini tramite lidar e mappatura mobile. Si tratta degli stessi requisiti che i nostri clienti si aspettano dai nostri apparati di registrazione dati utilizzati per il monitoraggio di reti wireless e i sistemi di collaudo automotive o dai data logger per il collaudo di veicoli che memorizzano e analizzano flussi di dati ad alta velocità provenienti da sensori esterni su unità a stato solido o hard disk”.

**Uno sguardo in profondità**

I nuovi moduli conga-TC370 in formato COM Express con pinout Type 6, gli SBC embedded da 3,5” conga-JC370 e le schede madri conga-IC370 in formato Thin Mini-ITX sono tutti equipaggiati con i processori embedded Intel® Core™ i7, Core™ i5, Core™ i3 e Celeron di ultima generazione con disponibilità garantita per un periodo di 15 anni. La memoria è stata progettata per soddisfare le esigenze di applicazioni che prevedono la coesistenza di più sistemi operativi su una singola piattaforma: sono disponibili due zoccoli per moduli SODIMM DDR4 in grado di operare a 2.400 MT/s per una capacità totale massima di 64 GB. Per la prima volta USB 3.1 Gen2 è supportato in modo nativo

e può operare a una velocità massima di 10 Gbps, rendendo in tal modo possibile il trasferimento di segnali video in formato UHD non compresso da una telecamera USB o da qualsiasi altro tipo di sensore di visione. Per fornire questo tipo di prestazioni, il nuovo SBC da 3,5” prevede un connettore USB-C che supporta anche un'interfaccia DisplayPort++ (dual-mode) e la funzionalità di erogazione della potenza per i dispositivi periferici: in questo modo è possibile la connessione con un monitor utilizzando un singolo cavo per il video, le funzioni di rilevamento tattile e la potenza. I moduli in formato COM Express supportano il medesimo insieme di caratteristiche sulle schede carrier. Sono disponibili altre interfacce a seconda del fattore di forma, ma tutte le soluzioni proposte supportano fino a 3 display UHD indipendenti (a 60 Hz) con risoluzione massima di 2096x2304 pixel, oltre a una porta Gigabit Ethernet (una con supporto TSN). Queste nuove schede e moduli mettono a disposizione queste e altre interfacce pur garantendo un TDP di soli 15 W, scalabile da 10 W (nel funzionamento a 800 MHz) a 25 W (nel funzionamento in modalità Turbo Boost a una velocità massima di 4,6 Ghz).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Processori** |  | **N° di core/Threads** |  | **Freq. base / Max. Freq. di boost [GHz]** |  | **TDP Base**  **[W]** |  | **Intervallo di temperatura** |
| **Intel® Core™ i7 8665UE** |  | 4 / 8 |  | 2.0 / 3.4 |  | 15 |  | 0 to +60°C |
| **Intel® Core™ i5 8365UE** |  | 4 / 8 |  | 1.8/ 2.6 |  | 15 |  | 0 to +60°C |
| **Intel® Core™ i3 8145UE** |  | 2 / 4 |  | 1.8 / 2.2 |  | 15 |  | 0 to +60°C |
| **Intel® Celeron® 4305UE** |  | 2 / 2 |  | 1.8 |  | 15 |  | 0 to +60°C |

Ulteriori informazioni sulla nuova tecnologia dei processori Intel Core di 8a generazione e sulle schede e moduli corrispondenti di congatec sono disponibili all'indirizzo: <https://www.congatec.com/intel-whiskey-lake>

**Chi è congatec**  
congatec è un fornitore leader di moduli di elaborazione industriali che utilizzano fattori di forma standard COM Express, Qseven e SMARC, oltre che di computer monoscheda (SBC) e di servizi di personalizzazione. I prodotti congatec possono essere utilizzati in molteplici settori e applicazioni, tra cui l'automazione industriale, la tecnologia medica, le forniture per il settore automobilistico, aerospaziale e dei trasporti. Il suo principale campo di competenza e know-how tecnico comprende esclusive funzioni BIOS estese, così come pacchetti completi di supporto per driver e schede. Successivamente alla fase di progettazione, ai clienti viene fornita assistenza tramite una gestione estesa del ciclo di vita del prodotto. I prodotti dell'azienda sono fabbricati da fornitori di servizi specialistici conformemente ai moderni standard di qualità. Azienda con quartiere generale a Deggendorf, Germania, congatec ha sedi in USA, Taiwan, Cina, Giappone, Australia, Gran Bretagna, Francia e Repubblica Ceca. Per ulteriori informazioni consultare il nostro sito web [www.congatec.com](http://www.congatec.com/) oppure tramite via [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) e [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel e Intel Core et Celeron sono marchi registrati di Intel Corporation negli Stati Uniti e in altri Paesi.*

1. Sulla base delle verifiche effettuare da congatec sui più recenti datasheet pubblicati dai principali competitor. [↑](#endnote-ref-2)